

**中信证券股份有限公司**  
**关于沈阳富创精密设备股份有限公司**  
**2025 年度持续督导跟踪报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

**一、持续督导工作概述**

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2025 年 9 月 3 日和 2026 年 4 月 28 日-29 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2025 年度内部控制自我评价报告、2025 年度内部控制鉴证报告等文件；

（3）查阅公司与第一大股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2025 年度审计报告、关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题。

## 三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

### (一) 业绩大幅下滑和亏损的风险

报告期内，公司营业收入保持稳步增长，但归属于上市公司股东的净利润持续为负。本期业绩大幅下降，主要系公司围绕“产能布局、人才储备、技术研发”三大战略方向，进行了前瞻性、系统性的高强度投入所致。公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。报告期内，公司采取的相关战略性举措包括：

产能布局方面，随着沈阳、南通、北京等新增产线逐步投产并完成转固，固定资产规模显著扩大。截至报告期末，固定资产规模 49.02 亿元，较上年增长 22%，本年折旧费用 3.61 亿，较上年同比增长 39%。

人才储备方面，为支撑新增基地的高效运营与管理协同，公司持续强化人才梯队建设，人工成本较上年同期大幅增长，截至报告期，本年人工成本 8.71 亿元，较上年同比增长 20%。

技术研发方面，面对先进制程迭代的行业机遇，公司坚持创新驱动，新增匀气盘、特殊涂层、加热盘、静电卡盘及阀门五大专项，并持续加大核心技术研发投入。报告期内，研发费用 2.73 亿元，较上年同比增加 24%。

上述战略性投入在夯实公司长期发展根基、提升核心竞争力的同时，短期内对经营性利润形成了较大压力，导致报告期内业绩出现阶段性亏损。

## **（二）经营风险**

### **1、规模增长带来的管理风险**

公司产品具有多品种、小批量、定制化的特点，与之相匹配的离散型制造模式对公司的管理能力要求较高。公司生产经营规模持续增长、组织架构日益庞大，管理、技术和生产人员数量持续增加，且海内外战略布局存在的跨区域生产等均对公司的管理层和内部管理水平提出了更高的要求。如公司管理能力不能及时匹配公司经营规模增长，将影响公司的生产经营和长远发展。

### **2、产能储备与市场开发错配的风险**

在行业景气度提升过程中，产业往往加大资本性支出，对相关设备的采购需求增多；在行业景气度下降过程中，产业则可能削减资本支出，进而对设备的采购需求有所下降。公司在报告期内储备产能但存在订单不及预期，短期内导致折旧增加，利润承压的风险。

### **3、技术与研发风险**

**技术迭代风险：**半导体设备工艺制程快速演进，研发进度滞后将失去竞争优势；摩尔定律逼近极限，制程技术进步难度加大，研发失败风险存在。

**研发投入与转化风险：**研发费用持续增加，研发成果转化效率不高可能对净利润造成持续性压力；新产品验证周期延长或客户反馈不理想将直接影响订单获取。

## **（三）财务风险**

### **1、毛利率波动风险**

报告期内，公司产品毛利率为 22.23%，受半导体行业技术迭代、行业景气度、产能预投节奏、地缘政治和原材料价格波动等多种因素影响，存在波动风险，具体包括但不限于：

(1) 半导体设备行业与宏观经济和半导体行业密切相关，且周期波动性更强，宏观经济和行业景气度和公司订单、收入和产能利用率呈正比；

(2) 公司为资本及技术密集型企业，考虑到建设周期，通常需预投产能以满足未来市场需求。若公司产能达产节奏与行业景气度错配，产能利用率和毛利率波动将进一步放大；

(3) 受产品结构变化影响，部分业务营收增速较快，但毛利偏低，其收入占比提升对公司综合毛利率水平构成一定阶段性影响。

## 2、存货增加导致的风险

报告期内，公司存货账面价值为 104,812.66 万元，占总资产的比例 11.80%，公司存货周转率为 2.83。公司存货水平受产品结构、市场需求关系、供需关系、生产计划与供应链管理、外部环境等因素共同影响。如未来公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将会对公司流动资金产生一定压力，且可能导致存货跌价准备上升，将对公司的资金周转或业绩造成不利影响。

## 3、应收账款风险

报告期内，公司应收账款账面价值为 135,230.60 万元，占总资产的比例为 15.22%，公司应收账款周转率为 2.78。随着零部件国产化的不断推进，国内半导体厂商崛起，回款周期较长的大陆地区客户收入和占比持续提升，如未来公司应收账款增长速度过快、主要客户付款周期延长，付款方式发生变化，公司应收账款周转率可能下降，继而可能对公司业绩造成不利影响。

## 4、财政补助政策变动的风险

报告期内，公司确认为当期非经常性损益的政府补助为 3,020.59 万元，若未来政策环境发生变化，公司可能无法持续获得政府补助。

## 5、汇率风险

报告期内，公司汇兑损失为 1,064.71 万元。人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，公司的销售、采购等环节均存在以外币计价的情形，公司难以预测市场、外汇政策等因素对汇率的影响程度。

#### （四）行业风险

##### 1、市场竞争与结构风险

行业竞争日趋激烈。尽管技术门槛较高，但美日等国际巨头在高端半导体设备精密零部件领域仍占据主导地位，形成显著壁垒。若竞争对手大幅扩产或实现技术突破引发价格战，或将导致公司产品毛利率承压，市场竞争力与经营业绩面临较大挑战。

##### 2、需求与周期性风险

行业呈现强周期性特征，与下游资本开支紧密相关。若宏观经济波动、算力需求不及预期，或消费电子、汽车电子等终端市场需求下滑，将直接导致下游客户削减资本开支，进而引发公司订单下滑、产能利用率不足。鉴于公司资本与技术密集属性，固定投入及研发支出刚性较大，业绩受行业周期波动的影响将更为显著。

#### （五）宏观环境风险

半导体零部件行业还面临宏观经济与市场环境的系统性压力，以及技术变革带来的结构性挑战。在宏观层面，全球经济增长放缓直接抑制半导体终端需求，特别是消费电子和工业应用领域的景气度；与此同时，原材料价格上涨推高半导体通胀现象，而国际贸易结算中的汇率波动进一步侵蚀企业盈利空间，三重外部压力叠加削弱行业整体抗风险能力。更深层的变革来自技术演进逻辑的转换：一方面，全球半导体技术通缩压力日益凸显，技术扩散加速及摩尔定律逼近物理极限，正打破传统垄断定价模式；另一方面，行业竞争逻辑发生根本性转变，从过去“抢新市场”的增量博弈变为“抢存量蛋糕”的零和竞争，竞争焦点由技术领先转向成本控制；此外，量子计算、光子芯片等颠覆性技术的崛起，可能从根本上改变现有行业格局，对传统零部件企业形成替代威胁。上述宏观环境压力与技术变

革风险相互交织，要求企业在战略层面既要强化成本管控与运营效率，又需前瞻布局下一代技术，以应对行业生态的深刻重构。

#### 四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

#### 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	354,343.63	303,956.79	16.58
归属于上市公司股东的净利润	-861.15	20,264.98	-104.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,170.64	17,190.34	-130.08
经营活动产生的现金流量净额	38,679.01	-5,214.84	不适用
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	445,378.91	458,817.42	-2.93
总资产	888,509.44	835,655.97	6.32
主要财务指标	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.79	-103.80
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.79	-103.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.17	0.67	-125.37
加权平均净资产收益率(%)	-0.19	4.46	减少4.65个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.14	3.78	减少4.92个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	7.72	7.28	增加0.44个百分点

##### 1、营业收入增长

报告期内公司实现营业收入 354,343.63 万元，同比增长 16.58%，主要受益于全球半导体市场需求持续释放及半导体产业链国产化进程加速。分产品类别：机械及机电零组件产品收入 239,666.25 万元，同比增长 15.00%，成为核心增长引擎。气体传输系统产品收入 110,641.58 万元，同比增长 25.85%，第二增长曲线保持稳步提升。

## 2、盈利能力提升

报告期内实现扣非归母净利润-5,170.64 万元，同比减少-130.08%，主要系公司围绕“产能布局、人才储备、技术研发”三大战略方向进行了前瞻性、高强度投入，相关战略性举措在夯实长期发展根基的同时，导致报告期内折旧费用、人工成本及研发费用等刚性支出显著增加，对短期经营性利润形成一定压力，但长期有望筑牢发展根基，提升持续盈利能力。

## 3、现金流管理优化

经营活动现金流净额为 38,679.01 万元，较上年同期大幅上涨，主要系公司持续优化管理经营性现金流，客户回款情况较好所致。

# 六、核心竞争力的变化情况

## （一）公司的核心竞争力

### 1、大客户战略下的客户资源壁垒，构建稳定增长引擎

在半导体设备精密零部件领域，公司凭借深度服务全球龙头企业的先发优势，构建了稀缺的国内外高端客户资源网络，已进入国内外主流半导体设备厂商的供应链体系，既包括国际知名半导体龙头设备厂商，也涵盖国内龙头设备厂商。由于半导体设备厂商对所选用的精密零部件要求极为苛刻，一旦确定合作关系往往长期深度绑定，而公司已通过多家国内外领先设备制造商的认证体系，凭借行业标杆效应的持续释放，建立的商业信誉与供应商记录为持续拓展提供强信用背书，形成“深化大客户合作-提升行业公信力-吸引增量客户”的良性循环。

大客户的技术规范持续驱动公司研发创新，推动公司在精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接工艺及气体传输系统集成技术等核心领域铸造深厚技术壁垒。2025 年，公司气体传输系统作为核心优势板块，订单与营收均实现同比大

幅增长，成功为国内龙头客户开发多款气柜设计方案并实现量产；同时，公司通过投资国际品牌 COMPART 深化技术协同，进一步深化与国际客户的黏性，加速气体传输系统板块的国产化进程与国内市场份额扩张，筑牢长期增长引擎。

## 2、平台化制造生态，打造全链路核心优势

依托工艺整合与柔性化制造模式，公司构建了平台化制造生态，可为客户提供全品类精密零部件解决方案，涵盖机械及机电零组件、气体传输系统等多样化产品，有效降低供应链复杂度并强化合作关系，形成技术整合、敏捷交付与品质保障的全链路平台竞争力。

作为国内少数能服务国际头部客户并具备覆盖全价值链的一站式制造能力的供应商，公司自 2011 年起基于与国际龙头客户的深度协同需求，持续推进供应链体系化建设，先后通过 SSQA 质量体系审核及数十个模块的 SPACA 认证。2025 年，公司持续对接国际客户标准，进一步完善全价值链一站式制造能力，构建起行业领先的流程管控优势，能够满足全球半导体设备领域对精密零部件制造的系统化、标准化及可追溯性要求，可支撑从金属零部件到复杂气路系统的全链条供应，精准匹配刻蚀、薄膜沉积、离子注入等多样化工艺需求。

同时，公司具备年开发多款精密零部件、年交付数万件核心产品的能力，依托平台化技术实现属地化定制生产，凭借柔性制造与可追溯性保障，构建从研发到交付的全链路优势，技术迭代与产品交付能力持续领跑国内行业，进一步巩固行业领导地位。

## 3、智能化工艺平台，构筑智能制造核心优势

公司通过前瞻性平台化战略突破行业高资本投入与技术碎片化瓶颈，构建起覆盖精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接工艺及气体传输系统集成技术的全链条技术体系，形成全品类工艺能力，具备行业内少有的工艺完备性，性能指标全面对标全球半导体设备龙头标准，有效解决行业“单一企业仅深耕个别工艺”的局限，通过全品类供应显著降低客户供应链复杂度，可充分满足先进制程对零部件高精密、高洁净、高耐腐蚀、高耐击穿电压的严苛性能要求。

公司基于半导体精密零部件共性技术平台，实现复杂首件的模块化拆解与工

艺参数自优化闭环控制，结合智能判异系统与一体化在线检测，在多品种、小批量生产场景下达成动态平衡。2025年，公司持续加大研发投入，设立五大专项，推动多项先进制程配套产品实现量产与研发落地；在匀气盘领域完成多品类技术突破，相关涂层工艺与产品性能达到行业领先水平，将传统定制化开发转化为模块化快速响应，使离散制造产能弹性释放，支撑头部客户交付周期，最终形成“工艺广度-制造深度-响应速度”三位一体的智能制造核心优势。

#### 4、全球化产能矩阵，筑牢战略竞争壁垒

公司基于对半导体产业链“区域化重构”的前瞻预判，率先构建以属地化工厂为载体的全球化产能矩阵，通过“本土化+区域协同”战略实现高效资源配置，覆盖全球关键市场，有效分散区域政策风险，构筑起难以被竞争对手复制的综合优势。

在运营层面，公司通过“本地工厂-区域客户”的短链模式，持续优化全球供应链响应速度，通过物理隔离与本地化生产满足国内外客户对技术保密性及IP安全的刚性需求，为国内外客户提供符合要求的“可信制造环境”。同时，公司通过投资国际品牌COMPART、布局境外全资子公司等方式，深化技术协同与国际客户合作，进一步扩大国际业务规模，拓宽产品线，保持技术领先性，增强盈利水平，提高全球供应链采购能力，有效提升国际市场工艺、产品、质量优势，为公司构建全球化供应链新格局奠定战略支点。

### （二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出变化

单位：万元

项目	2025年度	2024年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	27,349.93	22,139.81	23.53%
资本化研发投入	-	-	-

研发投入合计	27,349.93	22,139.81	23.53%
研发投入总额占营业收入比例 (%)	7.72	7.28	增加0.44个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

公司持续加大研发投入，2025 年度，公司研发投入为 27,349.93 万元，同比增加 23.53%。

## (二) 研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能涂层工艺开发项目	22,135.10	6,373.32	18,373.60	持续研发	1、实现在刻蚀等关键涂层零部件上所使用的钽基粉末原材料自主可控；2、建立半导体核心零部件对铝合金原材料的应用标准；3、完成产品清洗标准制定；4、实现化学镀镍超高磷含量能力	国内领先	可应用于刻蚀、CVD、ALD、PECVD 等关键制程设备中核心零件
2	核心功能部件开发项目	30,473.41	8,184.82	20,678.66	持续研发	1，实现匀气盘孔径一致性、表面洁净度、流量一致性等技术突破；2、攻克阀门密结构设计及运行可靠性检测、机构动密封等“卡脖子”技术，研发出阀类产品，实现国产化替代；3、针对先进制程刻蚀、镀膜设备气体传输系统，建立传输管路内壁镀膜能力，提升管路内壁耐腐蚀性，满足更严格的腐蚀环境，实现管路内壁镀膜国产替代，解决国外对该类零部件的卡脖子问题；4、实现高精度单路隔膜阀自主结构设计及流导仿真能力，搭建超高纯性能测试系统与平台，完成高精度流道加工能力，实现密封面滚压硬化技术	国内领先	可应用于刻蚀、薄膜沉积、CVD、PECVD 等设备。

3	精密机械制造工艺优化项目	21,656.58	9,177.78	11,914.52	持续研发	1、打造专线制造模式，提高制造效率，降低制造成本；2、建立复杂多层结构气盘、热盘类焊接制造能力，实现关键核心零部件的国产化替代；3、实现刀具管理数字化建设，先进设备性能与刀具性能的双高效输出；4、推进集成电路装备零部件产业链供应链上下游企业数据打通，推动高端装备制造行业的数字化转型与智能化升级	国内领先	生产制造领域
4	气体传输系统工艺技术开发项目	11,838.49	3,614.02	7,645.34	持续研发	通过定制开发专属制造设备和信息化系统实验切割，折弯，清洗，气柜组装，气柜测试的自动化生产，实现重点制造工序的全自动监控，确保信息全流程可追溯性。实现配套管路件、气体传输系统等国产化气体传输零部件制造。	国内领先	应用于 ETCH、CVD、ALD、ALE、IMP 等关键制程设备中 VCR 及 IGS 类型的气体传输管系统
合计	/	86,103.58	27,349.93	58,612.12	/	/	/	/

#### 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增主营业务。

#### 九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

本持续督导期间，公司第一大股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持股不存在新增质押、冻结及减持情况。除股权激励归属和公司第一大股东通过集中竞价交易方式增持外，公司第一大股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员直接持股不存在其他变化。

## 十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

上市公司于 2025 年 6 月 7 日和 2025 年 12 月 9 日分别披露《沈阳富创精密设备股份有限公司关于实际控制人所持第一大股东部分股权被冻结的进展公告》（公告编号：2025-033）和《沈阳富创精密设备股份有限公司关于实际控制人所持第一大股东部分股权被冻结的进展公告》（公告编号：2025-083），2024 年 6 月，公司实际控制人郑广文先生直接持有的公司第一大股东沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）831.17 万元出资额被北京市监察委员会冻结（京监冻(2024)130003 号），冻结期限自 2024 年 6 月 6 日起至 2025 年 6 月 6 日止。由于前述事项尚未调查完毕，上述出资额冻结期限将延长自 2025 年 6 月 6 日起至 2026 年 6 月 6 日止。上述事项具体情况详见该公告内容。

经核查，保荐人认为：如郑广文先生所持被冻结的沈阳先进 831.17 万元出资额被执行，郑广文先生仍可控制沈阳先进 50%以上股权进而仍继续控制沈阳先进直接持有的上市公司 18.00%股权，仍为公司控制股权比例第一大股东，不存在公司实际控制人变更的风险。后续保荐人将继续关注上述股权冻结事项的进展情况，督促公司跟进事项进展并及时履行信息披露义务。

上市公司于 2025 年 2 月 15 日披露《沈阳富创精密设备股份有限公司关于公司及相关人员收到辽宁证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-009），因公司自 2023 年 2 月与 A 公司发生交易购买产品，A 公司实为富创精密关联方，上述交易构成关联交易。公司未对相关交易及时审议并披露。中

国证券监督管理委员会辽宁监管局对公司及公司董事长郑广文、时任财务总监杨爽、处罚时点时任总经理张璇、财务总监崔静、董事会秘书梁倩倩采取出具警示函的行政监管措施。公司及相关人员收到上述决定书后，高度重视上述问题，并严格按照决定书的要求对存在的问题进行整改，按照关联交易履行披露程序，披露《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-085）。保荐机构将切实履职尽责，积极协助公司整改，并持续关注和跟进其整改进展情况。

除前述情况外，基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。保荐人提示广大投资人关注投资风险。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司  
2025 年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

张欢

张 欢

张明慧

张明慧

